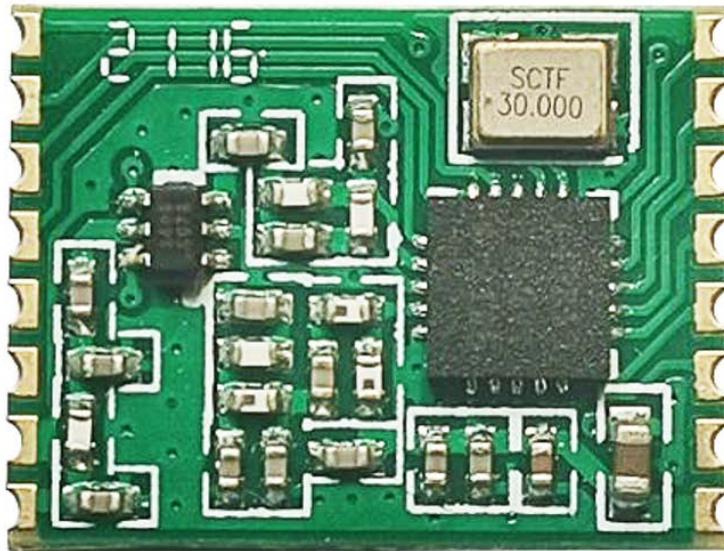


SI4463SxS 系列无线模块 硬件规格书

V1.1



(图片仅供参考)

目录

一、概述.....	1
二、主要技术参数.....	3
三、引脚位置图.....	4
四、引脚说明.....	5
五、硬件设计指导与注意事项.....	6
5.1、硬件连接示意图.....	6
5.2、电源设计与相关注意事项.....	7
5.3、天线设计与指导.....	7
六、编程开发注意事项.....	10
七、回流焊曲线图.....	11
八、静电损坏警示.....	11
九、封装信息.....	12
机械尺寸(unit:mm).....	12
十、版本更新说明.....	13
十一、采购选型表.....	13
十二、声明.....	13
十三、联系我们.....	14

一、概述

SI4463SxS 系列无线模块，是基于 Silicon Labs 的 SI4463 高性能无线收发芯片设计的一款体积小、低功耗、远距离的双向无线收发模块。

Silicon Laboratories 的 Si4463 器件是一款高性能、低电流的射频收发器，可覆盖 142 至 1050MHz 全球主要 sub-GHz ISM 频段，并具有低至 -129 dBm 的出色接收灵敏度。模块高达+20dBm 的输出功率与出色的高接收灵敏度，确保在恶劣的工作条件下仍可提供稳健的通讯链接预算。模块可以满足全球监管标准：FCC、ETSI、无线 MBus 和 ARIB。该模块工作参数配置非常灵活，具体配置文件可以通过 Silicon Labs 网站上的 Wireless Development Suite (WDS) 工具生成。

模块集成了所有射频相关功能和器件，用户不需要对射频电路设计深入了解，就可以使用该模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线方案与无线物联网设备。

产品主要特点：

- 频率范围=142 - 1050 MHz
- 最佳接收灵敏度= -129 dBm
- 支持调制方式
 - (G)FSK, 4(G)FSK, (G)MSK
 - OOK
- 最大输出功率
 - +20 dBm
- 低接收电流
 - 13 mA 接收电流
- 低功耗模式
 - 关机模式 30nA
 - 休眠模式小于 1uA
- 通信速率 100 bps 到 500Kbps 可编程配置
- 宽供电电压范围 1.8 至 3.8 V
- TX 和 RX 64 字节 FIFO
- 符合 IEEE 802.15.4g 和 WMBus 标准

- 适用于 FCC 第 90 部分 Mask D, FCC 第 15.247、15231、15249 部分, ARIB T-108, T-96, T-67, RCR STD-30, 中国监管

应用:

- 物流跟踪、仓库巡检、电子标签等
- 替代 232、485 进行无线数据通信
- 工业仪器仪表无线数据采集和控制
- AMR (水、电、煤气) 三表抄表
- 建筑物与住宅 (智能家居) 控制
- 电子消费类产品无线遥控
- 无线报警与安全系统
- 无线传感器网络

二、主要技术参数

技术指标	参数	备注
电压范围	1.8~3.8V	一般 3.3V
频率范围	433MHz/868MHz/915MHz	适用频段由模块型号决定
输出功率	-37dBm to +20dBm	可编程配置
无线速率	0.1kbps ~ 500Kbps@FSK	可编程配置
晶振频率	30MHz	无源晶振
调制方式	(G)FSK	
接收灵敏度	-127dBm	500bps, GFSK, BT = 0.5
接收带宽	0.2kHz ~ 850kHz@FSK	可编程配置
发射电流	80mA	发射功率 = 20dBm
接收电流	13.7mA	
休眠电流	<1uA	
驱动接口	SPI	标准 4 线 SPI, SPI 时钟: ≤10MHz CPOL = 0, CPHA = 0
天线阻抗	50 欧姆	
天线连接方式	侧边邮票孔	
存储温度	-55°C~+125°C	
工作温度	-40°C~+85°C	工业级
尺寸大小	16.0x 12.0mm	

三、引脚位置图

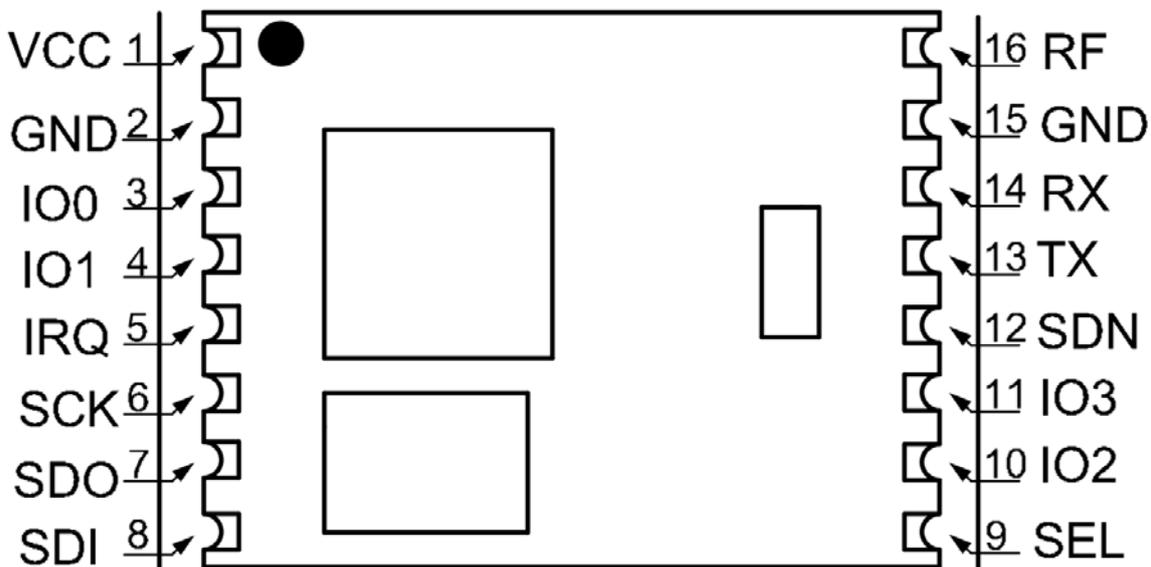


图 3-1 俯视图

四、引脚说明

序号	引脚	类型	描述
1	VCC	电源	电源正极
2	GND	电源	地
3	I00	I/O	直连芯片 GPIO1 数字 I/O 引脚，软件可配置功能
4	I01	I/O	直连芯片 GPIO1 数字 I/O 引脚，软件可配置功能
5	IRQ	0	芯片 NIRQ 中断输出信号，产生中断时输出低电平
6	SCK	I	SPI 接口 SCLK 时钟输入
7	SDO	0	SPI 接口 MISO 数据输出
8	SDI	I	SPI 接口 MOSI 数据输入
9	SEL	I	SPI 接口片选输入
10	I02	I/O	直连芯片 GPIO1 数字 I/O 引脚，软件可配置功能
11	I03	I/O	直连芯片 GPIO3 数字 I/O 引脚，软件可配置功能
12	SDN	I	芯片关机控制脚 SDN=0，除关机模式 (shut down) 的所有模式该引脚必须置低电平 SDN=1，模块将被彻底关闭并且内部寄存器的内容将丢失
13	TX	I	模块射频开关发射通路控制脚，发射时 TX=1；RX=0
14	RX	I	模块射频开关接收通路控制脚，接收时 RX=1；TX=0
15	GND	电源	地
16	RF	I/O	RF 信号输入/输出，接 50Ω 天线

五、硬件设计指导与注意事项

5.1、硬件连接示意图

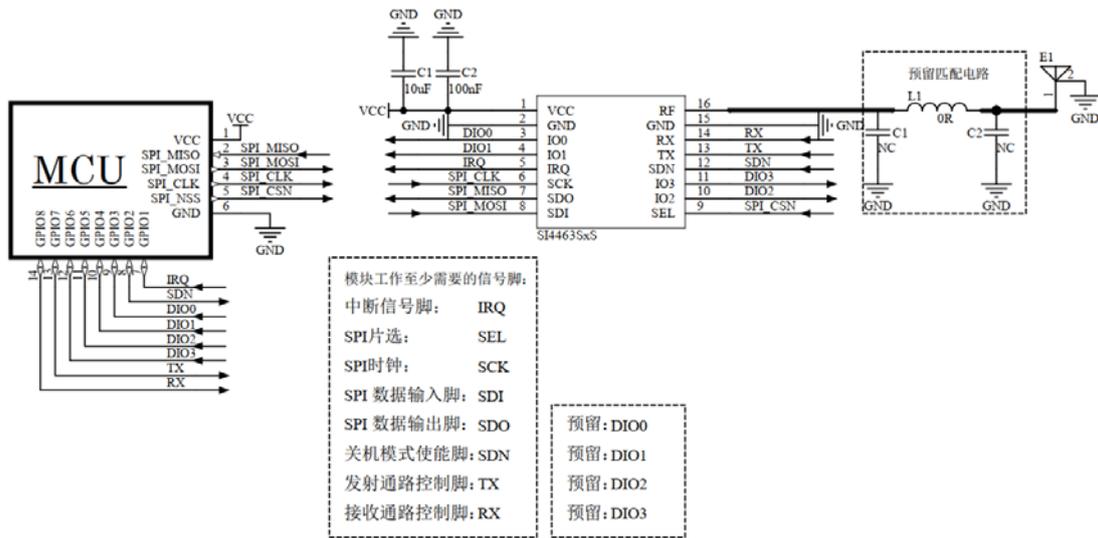


图 5-1 编程开发硬件连接(利用 MCU 控制 RX\TX 脚)

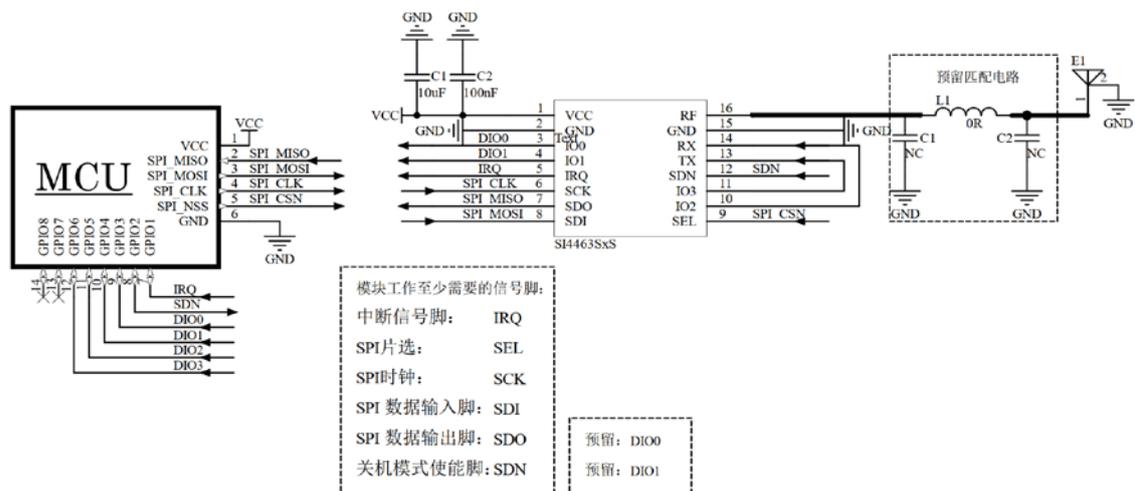


图 5-2 编程开发硬件连接(利用模块 I/O2、I/O3 控制 RX\TX 脚)

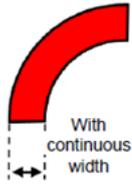
5.2、电源设计与相关注意事项

- 1、请注意电源正负极的正确接法，并确保电源电压在推荐供电电压范围，如若超出模块最大允许供电范围，会造成模块永久损坏；模块电源脚的滤波电容尽量靠近模块电源引脚。
- 2、模块供电系统中，过大的纹波可能通过导线或者地平面耦合到容易受到干扰的线路上，例如天线、馈线、时钟线等敏感信号线上，容易引起模块的射频性能变差，所以我们推荐使用 LDO 作为无线模块的供电电源。
- 3、选取 LDO 稳压芯片时，需要注意电源的散热以及 LDO 稳定输出电流的驱动能力；考虑整机的长期稳定工作，推荐预留 50%以上电流输出余量。
- 4、最好给模块单独使用一颗 LDO 稳压供电；如果采用 DC-DC 电源芯片，后面一定加一个 LDO 作为模块电源的隔离，防止开关电源芯片的噪声干扰射频的工作性能。
- 5、MCU 与模块之间的通信线若使用 5V 电平，必须串联 1K-5.1K 电阻(不推荐，仍有损坏风险)。
- 6、射频模块尽量远离高压器件，因为高压器件的电磁波也会对射频信号产生一定的影响。
- 7、高频数字走线、高频模拟走线、大电流电源走线尽量避开模块下方，若不得已必须经过模块下方，需走线在摆放模块的 PCB 底板另一层，并保证模块下面铺铜良好接地。

5.3、天线设计与指导

5.3.1 邮票孔接口 RF 设计

选择模块射频输出接口为邮票孔形式时，在设计时用 50ohm 特征阻抗的走线来连接底板 PCB 板上的天线。考虑到高频信号的衰减，需要注意底板 PCB 射频走线长度需尽量短，建议最长走线长度不超过 20mm，并且走线宽度需要保持连续性；在需要转弯时尽量不要走锐角、直角，推荐走圆弧线。

<p>首要推荐的射频走线转弯方式</p>	
<p>其次推荐的射频走线转弯方式</p>	
<p>比较糟糕的射频走线转弯方式，不推荐</p>	

为尽量保证底板射频走线阻抗为 50 欧姆，可以根据不同板厚，按照如下参数进行调整。以下仿真值，仅供参考。

<p>射频走线采用 20mil 线宽</p>	<p>板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.3mil</p>
	<p>板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.1mil</p>
	<p>板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 5mil</p>
<p>射频走线采用 25mil 线宽</p>	<p>板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 6.3mil</p>
	<p>板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 6mil</p>
	<p>板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.7mil</p>
<p>射频走线采用 30mil 线宽</p>	<p>板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 7.6mil</p>
	<p>板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 7.1mil</p>
	<p>板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 6.6mil</p>

5.3.2 内置天线

内置天线是指焊接在 PCB 底板上放置在产品外壳内部的天线，具体包括贴片陶瓷天线、弹簧天线等。在使用内置天线时，产品的结构与天线的安装位置对射频性能有较大影响，在产品外壳结构空间足够的前提下，弹簧天线尽量垂直向上放置；天线摆放位置的底板周围不能铺铜，或者可以将天线下方的电路板挖空，因为金属对射频信号的吸收和屏蔽能力非常强，会严重影响通讯距离，另外天线尽量安放在底板的边缘。

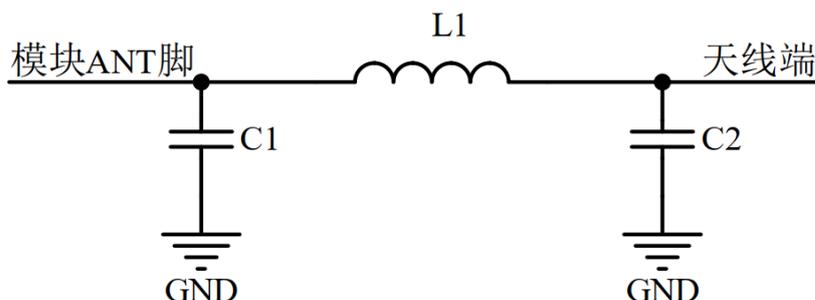
5.3.3 外置天线

外置天线是指模块通过 IPEX 延长线，SMA 等标准射频接口安装在产品外壳外面的天线，具体包括棒状天线、吸盘天线、玻璃钢天线等。外置天线基本是标准品，为更好的选择一款适用于模块的天线，在天线选型的过程中对天线的参数选择，应注意如下：

- 1、天线的工作频率和相应模块的工作频率应一致。
- 2、天线的输入特征阻抗应为 50ohm。
- 3、天线的接口尺寸与该模块的天线接口尺寸应匹配。
- 4、天线的驻波比（VSWR）建议小于 2，且天线应具备合适的频率带宽（覆盖具体产品实际应用中所用到的频点）。

5.3.4 天线的匹配

天线对射频模块的传输距离至关重要。在实际应用中，为方便用户后期天线匹配调整。建议用户在设计原理图时在天线和模块 ANT 脚输出之间预留一个简单的 π 型匹配电路。如果天线已经是标准的 50 Ω ，元器件 L1 贴 0R 电阻，器件 C1, C2 不需焊接，否则需要使用网络分析仪测量天线实际阻抗并进行匹配来确定 C1, L1, C2 的取值情况。模块 ANT 脚到天线端的走线要尽量短，建议最长走线长度不超过 20mm。



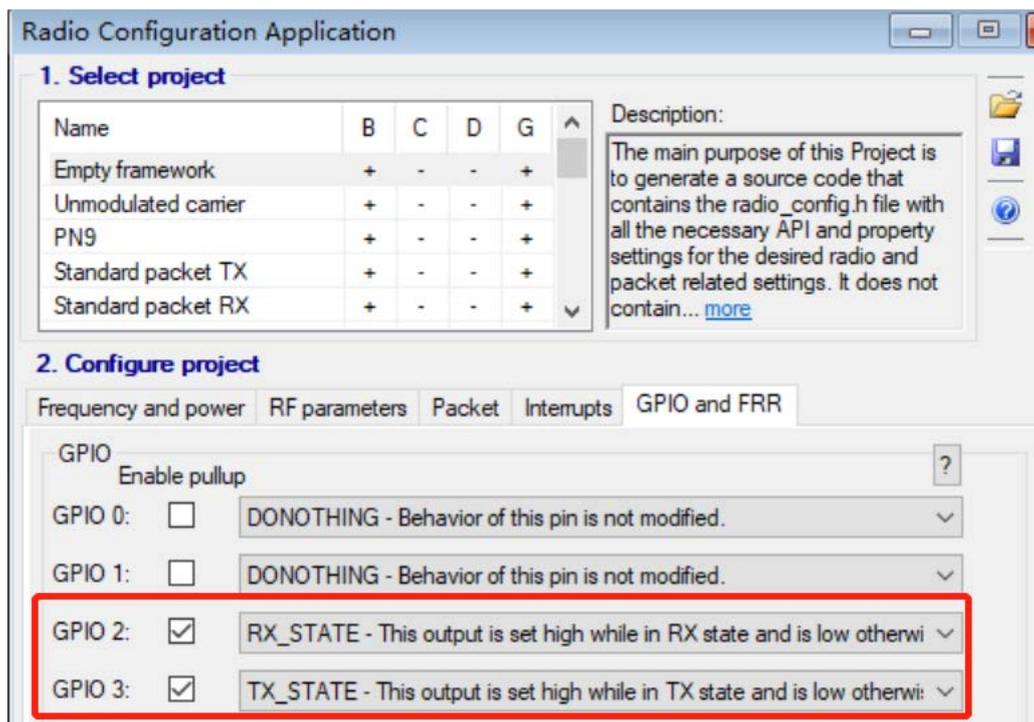
5-3 π 型匹配电路

六、编程开发注意事项

1、模块的 TX、RX 脚用来控制模块内部射频开关收发通路，当使用 MCU 口对其控制时其硬件连接方式如图 5-1 所示。其控制电平逻辑如下表所列：

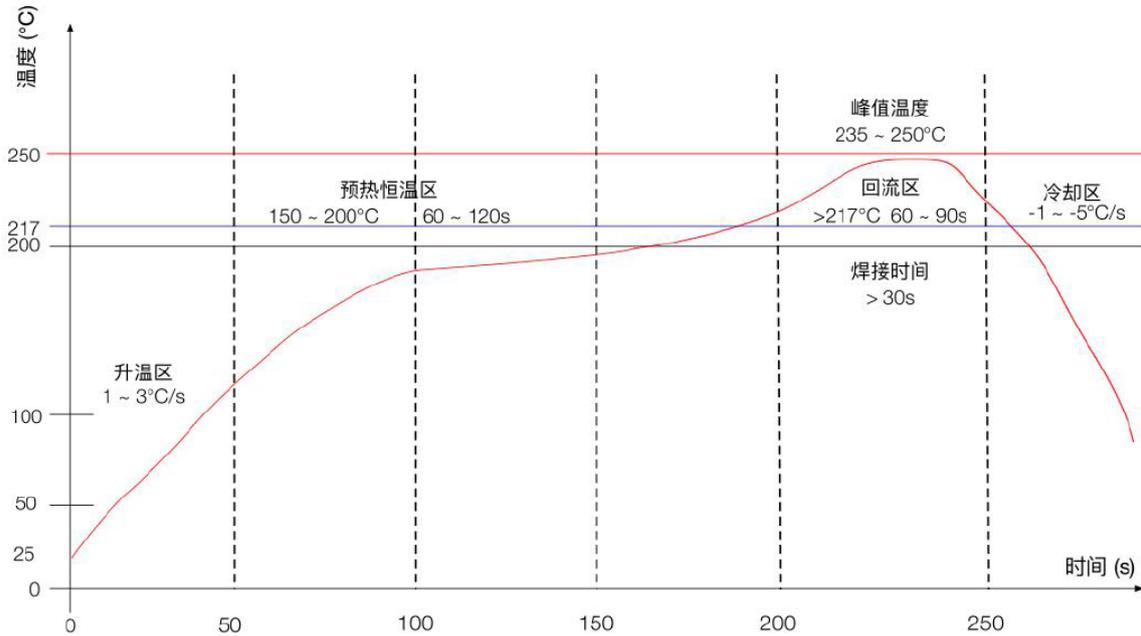
模式	TX 引脚	RX 引脚
发射	1	0
接收	0	1

2、当为了节省 MCU 可利用 IO 口数量时，也可以利用模块本身的 IO 口控制其 TX、RX，硬件连接方式见图 5-2。这个时候利用芯片的 GPIO2 脚与 GPIO3 脚来控制天线端射频收发通路开关逻辑，模块正常收发数据工作时需要对芯片的 GPIO2 与 GPIO3 进行配置，否则射频通路切换不正确，会导致通讯距离非常近。如下所示，利用 WDS 配置工具，分别把 GPIO2 配置为 RX_STATE，GPIO3 配置为 TX_STATE 即可。



3、一般射频芯片的接收灵敏度在其晶振的整数倍工作频点处相对比较差，建议用户在选用工作频点时注意要避开其模块晶振的镜像频点，即晶振频率的整数倍频点，本模块的晶振频率为 30MHz。

七、回流焊曲线图



升温区 — 温度: 25 ~ 150°C 时间: 60 ~ 90s 升温斜率: 1 ~ 3°C/s
 预热恒温区 — 温度: 150 ~ 200°C 时间: 60 ~ 120s
 回流焊接区 — 温度: >217°C 时间: 60 ~ 90s; 峰值温度: 235 ~ 250°C 时间: 30 ~ 70s
 冷却区 — 温度: 峰值温度 ~ 180°C 降温斜率 -1 ~ -5°C/s
 焊料 — 锡银铜合金无铅焊料 (SAC305)

八、静电损坏警示

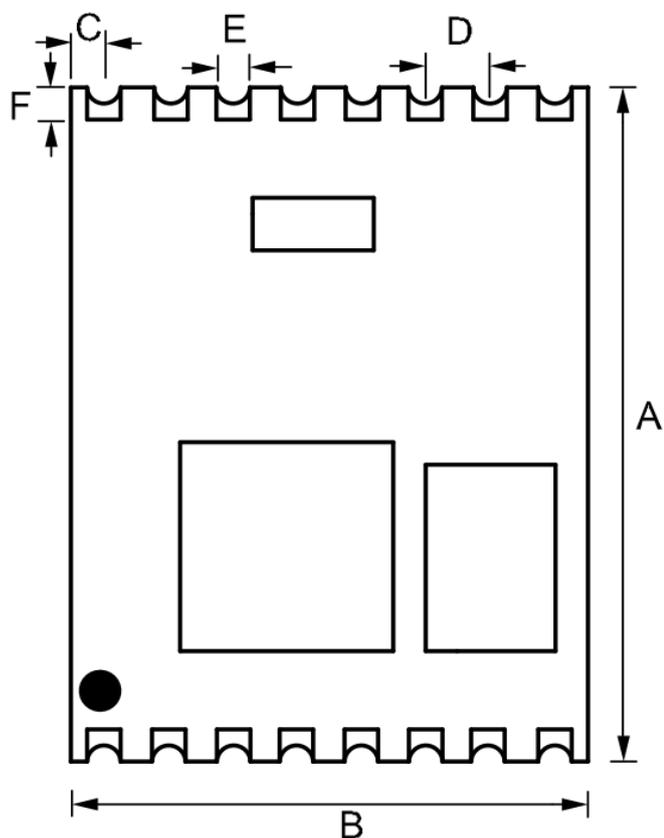
射频模块为高压静电敏感器件，为防止静电对模块的损坏

- 1、严格遵循防静电措施，生产过程中禁止裸手触碰模块。
- 2、模块应该放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高压输入处的防静电保护电路。



九、封装信息

机械尺寸(unit:mm)



编号	尺寸(mm)	误差(mm)
A	16.0	±0.5
B	12.0	±0.5
C	0.7	±0.1
D	1.5	±0.1
E	1.0	±0.1
F	0.7	±0.1
G	1.0	±0.1
H	1.9	±0.2



十、版本更新说明

版本	更新内容	更新日期	负责人
V1.0	第一次发布	2018年2月8日	DropLin
V1.1	<ul style="list-style-type: none"> ● 更新排版 ● 增加采购选型表 	2021年5月26日	DropLin

十一、采购选型表

序号	型号	说明
1	SI4463S4S-V1-B1B	433MHz 频段, B 版本, 编带包装\托盘包装
2	SI4463S4S-V1-C2A	433MHz 频段, C 版本, 编带包装\托盘包装
2	SI4463S8S-V1-B1B	868MHz 频段, B 版本, 编带包装\托盘包装
3	SI4463S8S-V1-C2A	868MHz 频段, C 版本, 编带包装\托盘包装
4	SI4463S9S-V1-B1B	915MHz 频段, B 版本, 编带包装\托盘包装
5	SI4463S9S-V1-C2A	915MHz 频段, C 版本, 编带包装\托盘包装

十二、声明

- 1、由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
- 2、本公司保留所配备全部资料的最终解释和修改权，如有更改恕不另行通知。

十三、联系我们

公司：深圳市沃进科技有限公司

地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区三合路 1 号智慧云谷 C 栋 205-208

电话：0755-23040053

传真：0755-21031236

官方网址：www.vollgo.com

商务合作：sales@vollgo.com

